

Title (en)  
Method for sealing blister packaging

Title (de)  
Verfahren zur Versiegelung von Blisterverpackungen

Title (fr)  
Procédé destiné au scellement d'emballages sous blister

Publication  
**EP 2090510 A1 20090819 (DE)**

Application  
**EP 08405042 A 20080215**

Priority  
EP 08405042 A 20080215

Abstract (en)  
The method involves sealing a blister base part (16) with a cup-shaped container by a sealable coating with a cover film (12), where the container comprises an opening and is molded out from a bottom film (18). The sealable coating is arranged as a self-adhesive layer (30) between the cover film and the blister base part, and sealing is activated by pressure, where the sealing layer contains a pressure-sensitive adhesive. The sealing layer is transferred on the blister base part or the cover film by a carrier film with non-stick coating.

Abstract (de)  
Bei einem Verfahren zur Versiegelung von Blisterverpackungen (10) wird ein Blisterbodenteil (16) mit wenigstens einem aus einer Bodenfolie (18) herausgeformten, eine Öffnung (21) aufweisenden napfförmigen Behältnis (20) über eine Siegelschicht (14) mit einer Deckfolie (12) versiegelt. Dabei wird die Siegelschicht als selbstklebende Schicht (30) zwischen der Deckfolie (12) und dem Blisterbodenteil (16) angeordnet und die Versiegelung im wesentlichen ohne Zufuhr von Wärme aktiviert.

IPC 8 full level  
**B65B 7/28** (2006.01); **B65B 9/04** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B65B 7/164** (2013.01); **B65B 7/2871** (2013.01)

Citation (search report)  
• [XY] US 2005252600 A1 20051117 - VAN DRIESTEN SJOERD J [NL]  
• [Y] US 6270871 B1 20010807 - SCHOLZ WILLIAM F [US], et al  
• [X] US 2003079446 A1 20030501 - BEHNKE MERLIN E [US]  
• [X] US 3472723 A 19691014 - LEMELSON JEROME H

Cited by  
CN103419953A

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2090510 A1 20090819**

DOCDB simple family (application)  
**EP 08405042 A 20080215**